

JAMA/JAPIA統一データシート改正内容のまとめ (Ver.2.11向け)

- 本資料は、JAMA/JAPIA統一データシートのバージョンアップ(Ver.2.11)による変更点をまとめたものです。 [2010年6月1日リリース予定]
- 最新版のJAMA/JAPIA統一データシートは、2010年6月以降、JAPIAホームページ (<http://www.japia.or.jp/>) より入手できます。
- JAMA/JAPIA統一データシートは、今後もバージョンアップされる可能性があります。

2010年6月1日
(社)日本自動車部品工業会
環境負荷物質WG

< Ver.2.11による改訂内容一覧表 >

ファイル	改訂項目	改訂内容	詳細説明
.入力 帳票	1 .表紙	・バージョン、日付を更新しました。	3ページ
.外部 リスト	2 .材料リスト MAT	・JIS規格の改訂内容を反映しました 材料リストに関する補足説明資料を参照下さい	(なし)
	3 .化合物リスト IMDS_SUB	・IMDS BSLの変更内容 (追加・修正・削除)を反映 しました。 ・これに伴い、化合物名称(日本語)を見直しました。 ・GADSL改訂(2010 Version)を反映しました。 ・REACH SVHC(高懸念物質)のフラグを修正 しました。(2010年1月13日、3月30日追加分)	(なし)
	4 .化合物の GADSL分類 IMDS_CATEGORY	・GADSL改訂(2010Version)に合わせ修正しました。	(なし)

(次ページに続く)

ファイル	改訂項目	改訂内容	詳細説明
.外部 リスト	5.アプリケーション リスト IMDS_APP IMDS_SUB_APP	・IMDSとの統合化のため、修正しました。	5ページ

.入力帳票の改訂内容

1.表紙

JAMA統一データシート

Ver.2.11
2010年6月1日

JAMA統一データシートの改正を、下記の通り実施します。

< 2010年6月1日 >
・欧州廃車指令(ELV)の適用除外リストAnnex)の改訂に伴い、IMDSのアプリケーションコードが変更されたため、外部リストを修正しました。
・欧州 REACH規則の SVHCが、2010年1月13日、3月30日に追加されましたので、外部リストを修正しました。
・入力帳票の内容に変更はありません。

< 2009年10月1日 >
・IMDSのバージョンアップに対応するため、小改訂版 (Ver.2.10)を発効しました。
改正内容の詳細につきましては、部工会ホームページ掲載の資料を参照して下さい。
・外部リストの改正も実施しましたので、Ver.2.10(EXLIST-2009-10-01JP) を利用して下さい。

< 2009年6月1日 >
・IMDSにてCr3+(三価クロムイオン)等イオン物質が削除されたため、外部リストを更新、関係する材料マスタを修正しました。
・入力帳票の内容に変更はありません。

(中略)

JAMA統一データシートの改正 (Ver.2.00)について

2006年4月1日
(社)日本自動車工業会
(社)日本自動車部品工業会

1. 改正の背景

(以下、省略)

< 変更点 >
バージョン、日付を更新
しました。

< 変更点 >
改正内容を追記
しました。

< 変更点 >
2007年以前の改正内容
を非表示にしました。

.外部リストの改訂内容

5 .アプリケーションリスト(IMDS_APP、IMDS_SUB_APP)

以下のアプリケーションコードが追加されます。

入力対象となる化合物 :Lead and its compounds (鉛および鉛化合物)

ID	アプリケーションコード(英語)	アプリケーションコード(日本語参考訳)
53	Lead in solder used in electronic circuit board applications - 8a)	電子回路基板用およびその他の電気部品用のはんだ中の鉛 - 8a)
54	Lead in solders in electrical applications other than soldering on electronic circuit boards or on glass - 8b)	電子回路基板用のはんだまたはガラス上のはんだを除く、電気部品用のはんだ付けに使用されるはんだ中の鉛 - 8b)
55	Lead in finishes on terminals of electrolyte aluminium capacitors - 8c)	アルミ電解コンデンサの端子仕上げ用のはんだ中の鉛 - 8c)
56	Lead used in soldering on glass in mass airflow sensors - 8d)	マスエアフロセンサー中のガラスのはんだ付けに使用する鉛 - 8d)
57	Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85 % by weight or more lead) - 8e)	高融点のはんだ中の鉛(対象となる高温はんだ: 鉛が85重量%以上含まれている鉛合金) - 8e)
58	Lead in compliant pin connector systems - 8f)	コンプライアントピン・コネクタシステム中の鉛 - 8f)
59	Lead in solders to complete a viable electrical connection between semiconductor die and carrier within integrated circuit flip chip packages - 8g)	集積回路のフリップチップ・パッケージ内の半導体ダイとキャリア間の、持続可能な電気接続を完全にするためのはんだ中の鉛 - 8g)
60	Lead in solder to attach heat spreaders to the heat sink in power semiconductor assemblies - 8h)	ヒートスプレッダをパワー半導体中のヒートシンクに接着するためのはんだに使用されている鉛 - 8h)
61	Lead in solders in electrical glazing applications on glass except for soldering in laminated glazing - 8i)	積層グレイジングを除く、ガラス上の電氣的グレイジング用のはんだ中の鉛 - 8i)
62	Lead in solders for soldering in laminated glazing - 8j)	積層グレイジングのはんだ付けに使用するはんだ中の鉛 - 8j)

削除されたアプリケーションコードはありません。

(注意事項)

- ・アプリケーションコードの変更に伴い、調査済の部品に対して一括した再調査を行うことは、サプライチェーンへの影響が大きいため実施しないで下さい。
新しく追加されたアプリケーションコードによる調査は、2011年1月以降の新型車両に搭載される部品から実施して下さい。
- ・はんだ中の鉛については、従来からアプリケーションコード= 13(電子回路基板用およびその他の電気部品用のはんだ :Solder in electronic circuit boards and other electric applications) がありました。
このアプリケーションコードも、以前の調査結果への影響を考慮し、残されていますが、2011年1月以降の新型車両に搭載される部品への調査には利用せず、新しいアプリケーションコードを利用するようにして下さい。
ただし、2011年1月以降の新型車両に搭載される部品でない場合は、引き続き、アプリケーションコード= 13 の利用が認められています。

(1) 外部リスト

互換性なし。

必ずVer.2.11の外部リストを利用して下さい。
旧バージョンの外部リスト(Ver.2.00 ~ Ver.2.10)は、
エラーチェックや選択入力が正しく動作しないため利用することができません。

(2) CSVファイル

互換性あり。

旧バージョン(Ver.2.00 ~ Ver.2.10)にて作成したCSVファイルでも
取り込みできます。
ただし、入力内容によっては、外部リストの見直しに伴い、
エラーが発生する可能性があります。データの修正が必要となります。